



NUMBER 178305
 METRIC
 3rd ANGLE PROJECTION
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST
 10/01
 REV:10/93

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED - (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
 コネクタ: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
- △ めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- △ めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- △ めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- △ めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部 -
 ニッケル下地の土に半田めっき

推奨基板取付け寸法
 PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

Copyright © 1991
 AMP(Japan) LTD.
 ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K
 Kawasaki, Japan

△	△	178305-5
△	△	178305-3
△	△	178305-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C1 REVISED (ECR-07-013273) T S D H		WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME タイプミック D3100 8平タイプ 10 極 ヘッダーアセンブリー	
C REVISED (FJ00-0039-03) T S S M		MATERIAL		FINISH		10 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASSY FOR DYNAMIC 3100	
B REVISED (FJ00-0097-03) T S S M		SEE NOTE		SEE NOTE		(GENERAL TOLERANCE)	
A REVISED (FJ00-2183-95) K I S M		RELEASED (J-1184) NM		DR. 16 JUN 91		SIZE LOC NUMBER	
O RELEASED (J-1184) NM		CHK 24/FEB/92		DE. 16 JUN 91		SCALE	
LTR REVISION RECORD DR CHK DATE		APP. S. MANGRE		10MM TOLERANCE		REV. [1] SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面